Поз. Обознач.	Наименование					Примечание
BA1	Динамик CVS-3108					SAMTEC
DAI	динамик С v S-3	100			1	SAMIEC
		<u>Ka</u>	онден	саторы		
C1, C2	Чип алюминиевый 47нФ 1608 50В					YAGEO
C3, C4	Чип керамический 100 пФ 1608 50 B					YAGEO
C5, C6	Чип керамический 22 пФ 1608 50 B					YAGEO
C7	Чип керамический 10 мкФ 1608 50 В					YAGEO
C8	Чип керамический 22 пФ 1608 50 B					YAGEO
C9, C10	Чип керамически	Чип керамический 100 пФ 1608 50 B				
C11	Чип керамический 22 пФ 1608 50 B				1	YAGEO
	<u>Диоды</u>					
D1	HEPR0056RT, $5.1 \pm 5\%$ B, 200 мВт					Motorola
D2D7	CLA1A-WKW-CXAYB153, 5В , 100мА					CREE
	Схемы интегральные аналоговые					
DA1	NCP1117ST50T3G					ON Semiconductor
DA2	LM358D				1	ST Microelectronics
	Схемы интегральные цифровые					
DD1	CH340	CH340 1 ON Semiconduc				
DD2	PCF8574N					Texas Insturments
DD3	ATMEGA328P-AU					Atmel
					• • • •	
Изм. Лист	No domini II	lodu	Дата	ГУИР.42572.	3.002	1193
<u> Разраб.</u>	№ докум. П Шостко	oon.	дити		Лит	Лист Листов
Пров.	Смирнова			Система управления	T	1 2
Т.контр.	Смирнова			кодовым замком со сканером отпечатка пальца Перечень элементов БГУИР, гр. 75070		<u>l</u>
Н. Контр.	Лихачев					ИР, гр. 750701
Утв.	Азаров					

Обозн.	Наименование	Кол.	Примечание		
TIL 1	П ~ I CD 20 4D	1	CANTEC		
HL1	Дисплей LCD 20-4B	1	SAMTEC		
PS1	Датчик расстояния HC-SR04	1	SAMTEC		
	<u>Резисторы</u>				
R1R3	Чип 1608 – 10 кОм ± 5%	3	Samsung		
R1R3	Чип 1608 – 1 кОм ± 5%	1	Samsung		
R5	Чип 1608 – 10 кОм ± 5%	1	Samsung		
R6	Чип 1608 – 1 кОм ± 5%	1	Samsung		
R7	Чип 1608 – 1 МОм ± 5%	1	Samsung		
R8R12	Чип $1608 - 1$ кОм $\pm 5\%$	5	Samsung		
SB1SB13	Кнопка 4-1437565-9	13	Motorola		
	<u>Разъёмы</u>				
XS1	PJ-038B	1	CUI Devices		
XS2	USB-A-S-F-B-SM2	1	SAMTEC		
XS3	PIC-ICSP	1	Olimex		
XS4XS7	TW-02-03-T-D-335-100	4	SAMTEC		
XS8	TW-03-12-L-S-765-200	1	SAMTEC		
ZQ1, ZQ2	Кварцевый резонатор ABM3-16.000MHZ-B4Y-T	2	ABRACON		
Ист	ГУИР.425723.0		$002 \Pi \ni 3$		
Изм. Лист	№ докум. Подп. Дата				